

Cestas De Limpieza De Obleas Ptfе Personalizadas, Portadores De Obleas De Silicio Para Semiconductores, Casetes De Fluoropolímero De Bajo Fondo

Número de artículo: PL-CP266



Introducción

Cestas de limpieza de obleas PTFE personalizadas de alta pureza para el procesamiento de semiconductores. Diseñadas para el análisis de trazas de bajo fondo y una resistencia química agresiva, estos casetes de fluoropolímero a medida aseguran una disolución cero y un manejo sin contaminación de las obleas de silicio en entornos de salas limpias críticas y laboratorios industriales.

[Aprende más](#)

Aplicación	Descripción	Beneficio clave
Limpieza RCA (SC-1/SC-2)	Eliminación de contaminantes orgánicos, capas delgadas de óxido e impurezas iónicas de las superficies de silicio.	Alta resistencia a mezclas de peróxido de hidrógeno e hidróxido de amonio.
Grabado con ácido fluorhídrico	Eliminación selectiva de capas de dióxido de silicio y pasivación superficial.	Inmunidad completa al HF, que de otro modo degradaría los portadores de cuarzo o vidrio.
Procesamiento de grabado Piranha	Eliminación agresiva de residuos orgánicos pesados y fotoresistente utilizando ácido sulfúrico y peróxido.	Mantiene la integridad estructural en entornos altamente exotérmicos y oxidantes.
Soporte de fotolitografía	Manejo de obleas durante el revelado, eliminación y enjuague de materiales fotoresistentes.	La resistencia a disolventes asegura que el portador no se hinche o ablande cuando se expone a eliminadores.
Enjuague post-CMP	Limpieza crítica de obleas después de la Planarización Mecanoquímica (CMP) para eliminar suspensiones abrasivas.	La superficie de baja generación de partículas asegura que las obleas permanezcan limpias después de la etapa de pulido.
Preparación de semiconductores compuestos	Limpieza especializada de obleas GaAs, GaN e InP para optoelectrónica avanzada.	El soporte de ranuras de precisión suave previene daños a materiales compuestos frágiles.
Limpieza ultrasónica/megasónica	Limpieza por vibración de alta frecuencia para desalojar partículas submicrónicas en agua desionizada.	Las propiedades del material amortiguan la vibración excesiva mientras permiten una transferencia de energía efectiva.

Categoría de parámetro	Detalle de especificación para PL-CP266
Material principal	PTFE de alta pureza (Politetrafluoroetileno) / PFA (Perfluoroalquilo)
Método de fabricación	Mecanizado CNC de alta precisión (Fabricación personalizada)
Compatibilidad de tamaño de oblea	Totalmente personalizable (Tamaños comunes: 2", 3", 4", 6", 8", 12" o dimensiones a medida)
Configuración de ranuras	Espaciado, profundidad y cantidad personalizados según los requisitos del proceso
Diseño del asa	Fijo, extraíble o ojos de elevación integrados disponibles (Personalizable)
Resistencia química	Excelente (Compatible con todos los ácidos, bases y disolventes orgánicos)

Aplicación	Descripción	Beneficio clave
Categoría de parámetro	Detalle de especificación para PL-CP266	
Rango de temperatura de funcionamiento	-200°C a +260°C (Límite del material; específico de la aplicación)	
Rugosidad superficial	Acabado CNC controlado para una atrapamiento mínimo de partículas	
Fondo de elementos traza	Optimizado para el análisis de trazas de bajo nivel (Satisface necesidades de bajo fondo)	
Perfil de disolución	Disolución cero / Sin aditivos lixiviables (Sin lixiviación)	